

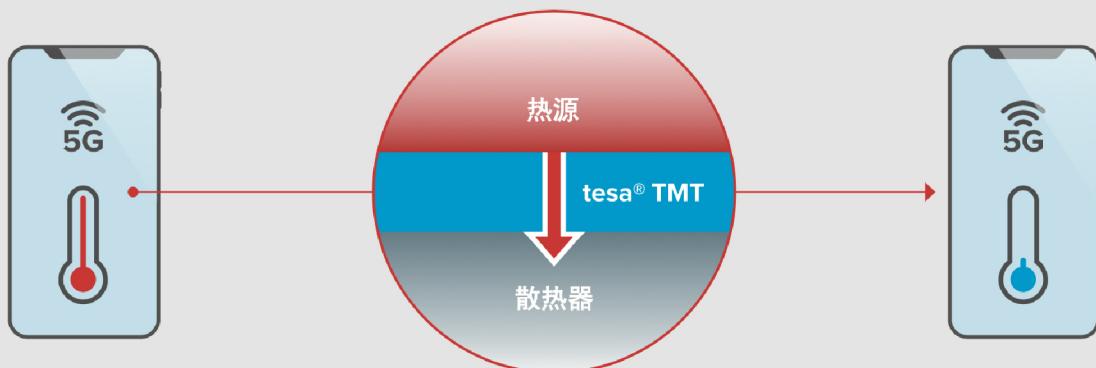


德莎热管理 胶带解决方案

tesa® TMT 热管理胶带解决方案，帮助电子设备散热。

5G技术和更高的能耗趋势，正在使电子设备内部元器件产生更多热量。过多的热量既会影响元器件，也会影响整个电子设备的性能及稳定性，由此降低终端用户的使用体验。德莎热管理胶带系列就可以有效帮助电子设备散热，解决热管理问题。

tesa® TMT— 热传导原理

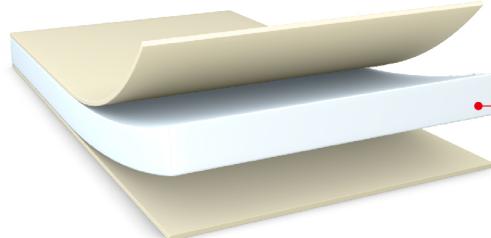


产品特性：

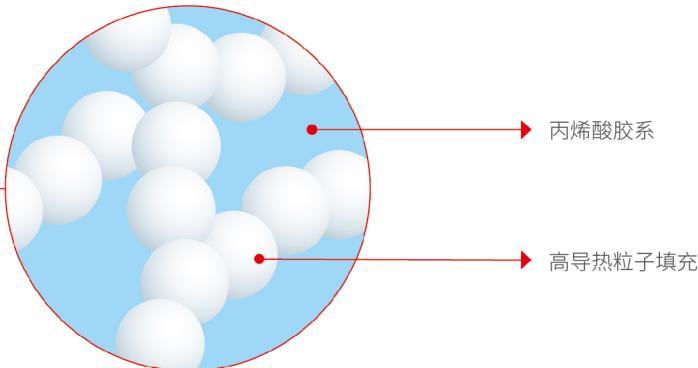
高导热性	强粘性	优秀的浸润性	高绝缘性	超薄设计

tesa® TMT 6074x 系列

tesa® TMT 6074x 提供卓越的热传导性能和优异的粘接性能。它在不同表面上有很好的浸润性，有助于最大限度地提高电子设备的热传导效率。可用的厚度范围从超薄的10μm至100μm不等，可以为元器件设计提供更多灵活性。



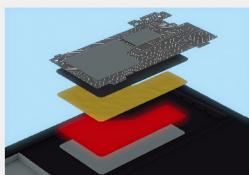
产品设计



性能概览

	tesa® TMT 60742	tesa® TMT 60743	tesa® TMT 60744	tesa® TMT 60745*
颜色	白色	白色	白色	白色
厚度 [μm]	10	30	50	100
导热率 [W/m x K]	0.6	1.0	1.0	1.0
剥离力 [N/cm]	3.5	4.0	5.0	> 5.0
浸润性 [%]	79	81	84	> 85
介电强度 [kV]	0.4	1.5	2.9	> 2.0

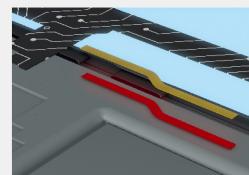
典型应用



均热板粘贴



5G 天线粘贴



热管粘贴

*产品研发中

寻找更合适的 解决方案？

德莎还有更多的产品选择。我们的专家可以
根据您的要求，提供定制的解决方案。

欢迎您通过邮件联系我们，或联系您的当地
销售代表：

tape.solution@tesa.com

扫码关注德莎社交媒体账号，及时获取更多新品发布
和样品使用申请资讯。



德莎胶带(上海)有限公司
电话:+86 21 68183110
tesa.cn/industry/electronics

tesa®产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被视为通用方案，不适合用作产品规格书。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包括(但不限于)对某一特殊应用场景的适用性或销售性的暗示保证。您须亲自确认德莎的产品是否适用于您提供的应用场景和特殊的应用场合。如果有任何疑问，我们专业的工程师团队将非常乐意为您提供专业的咨询。